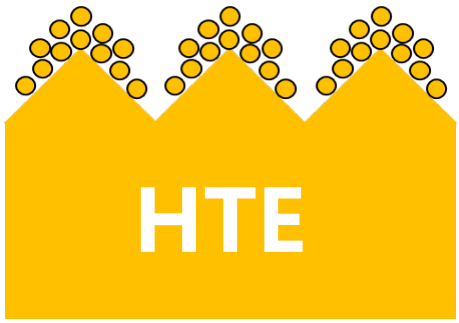
适配板材

★ 中高Tg环氧

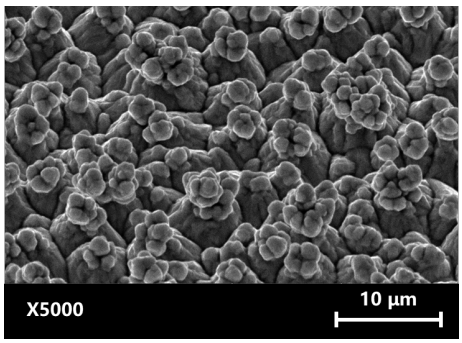
★ 中高Tg无卤环氧



典型应用

★ 多层板 (MLB)

★ 3C 消费电子



技术指标

项目		单位	规格参数				测试方法
标称厚度		μm	12	15	18	35	IPC-4562A
单位面积质量		g/m²	107	125	148	285	IPC-TM-650 2.2.12
抗拉强度	常温	MPa	300	300	300	300	IPC-TM-650 2.4.18
	180℃		150	150	150	150	
延伸率	常温	%	10	15	15	15	
	180℃		6.0	6.0	6.0	6.0	
粗糙度 Rz	压合面	μm	5.0	5.5	6.0	8.5	IPC-TM-650 2.2.17
	阻剂面		1.5	1.5	1.5	1.5	
剥离强度	FR4	lb/inch	7.0	7.5	8.0	11	IPC-TM-650 2.4.8

★ 以上数据为典型值，非保证值。

★ 半固化片会影响剥离强度，铜箔使用前请进行半固化片匹配实验或咨询德福科技技术服务人员。